

TIS®-30FIP 一种镍/石墨填充的导电硅胶，主要面向精密电子、通讯、军工、车载设备，实现EMI/RFI电磁屏蔽、壳体接地、静电泄放与密封缓冲功能。产品采用镍石墨高导填料，通过自动化点胶原位固化成型，可替代传统导电泡棉、模切导电垫片，适配窄边框、异形腔体等高可靠设备的电磁兼容整改需求。



特性

- 导电性能优异
- 高效阻隔射频干扰
- 适配量产精细化需求
- 固化后为柔软弹性凝胶材质

应用

- 新能源汽车车载电子
- 轻薄消费电子与工业精密设备
- 军工、航空航天与舰船设备
- 5G通信与数据中心设备

TIS®-30FIP 特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	黑灰色	目视
结构&成份	石墨镀镍填充硅橡胶	-
物理状态	膏状	-
表干时间 (min) @23°C, 50%RH	10~30	ASTM C679
固化深度 (mm) @24小时	3	-
密度 (g/cm ³)	2.1	ASTM D792
硬度 (Shore A)	45	ASTM D2240
建议使用温度范围 (°C)	-50 ~ 125	-
粘接强度 (N/cm ²) (铝对铝)	> 65	ASTM D1002
体积电阻率 (Ohm-cm)	< 0.3	MIL-DTL-83528C
屏蔽效能 (dB) @100Mhz-10Ghz	85-110	MIL-STD 285
阻燃等级	V-1	UL94

固化工艺和时间

1. 胶体接触空气中的湿气固化，一定时间内(10-30 分钟)胶体表面结皮。
2. 胶体是由表面向里面逐渐固化的。25°C及 50%相对湿度下 24 小时胶体的 固化深度是 2mm-3mm。很深的部分，尤其是不容易接触到湿气的地方需要更长的 时间才能固化完全，在湿度较低时，固化时间会相对应延长。在使用或包装粘接 好的部件前，用户最好能等足够长的时间以确保粘接部分完全固化。

储存与有效期

1. 低温冷冻储存，未开封的原包装产品保质期为 6 个月。
2. 开封后剩余产品在不使用时一定要牢固地密封保存，再次使用时在储存时容器的顶端可能会形成固化物，这个固化物很容易去掉，且不影响剩余产品的品质，可以继续使用。

全球方案：在地服务

中国：+86-769-38801208
台湾：+886-2-2277-1007
加拿大：+001-604-2998559
越南：+84-396852859
service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIS-30FIP-0726